

東北大学マイクロシステム融合研究開発センター
 試作コインランドリ
 主要装置リスト
 （2025年4月～）

■施設使用料（1人あたり）
 学外：600円/時間、学内：430円/時間

■技術支援料
 6,514円/時間
 （文科省マテリアル先端リサーチインフラ[ARIM]ご利用の場合、3,300円/時間）
 （改定前と同じ）
 （税込）

分類	番号	ARIM 機器ID	装置名称	メーカ/型番	ARIM データ提供あり 使用料 (円/時間)	ARIM データ提供なし 使用料 (円/時間)	非公開利用 使用料 (円/時間)	改定前 ARIM データ提供時 使用料	改定前 ARIM 使用料	対応ウェハサイズ	備考／簡単な仕様、装置の特徴等
洗浄・乾燥	A-01	TU-001	エッチングチャンバー	アズワン PSH1200	2,134	2,838	3,410	2,090	2,596	最大8インチ	酸洗浄、ウェットエッチング（Si, SiO2, 金属など）
	A-02	TU-002	有機ドラフトチャンバー	- -	2,112	2,816	3,388	2,068	2,574	最大6インチ	有機洗浄、レジスト剥離
	A-03	TU-003	リン酸槽	- -	2,486	3,300	3,960	2,398	2,992	最大8インチ	SiNウェットエッチング
	A-04	TU-004	スピンド乾燥機	東邦化成 ZAA-4	3,212	4,268	5,126	3,102	3,872	最大6インチ	平置き式でウェハやフォトマスクの乾燥
	A-05	TU-005	4"スピンド乾燥機	SEMITOOL PSC101	3,630	4,818	5,786	3,498	4,356	4インチ	カセット式で1度に25枚まで処理可能
	A-06	TU-006	6"スピンド乾燥機	SEMITOOL PSC101	3,630	4,818	5,786	3,498	4,356	6インチ	カセット式で1度に25枚まで処理可能
	A-07	TU-007	シンター用オープン	ヤマト科学 DR22	2,662	3,542	4,268	2,596	3,234	最大6インチ	N2雰囲気中での熱処理、Alシンタリングなど
	A-08	TU-008	真空オープン	ヤマト科学 DP-31	1,782	2,376	2,860	1,716	2,134	最大8インチ	真空中での熱処理
	A-09	TU-009	ブラシスクラバ	全協化成 特注	7,436	9,900	11,880	7,392	9,240	最大6インチ	研磨後のウェハ洗浄
リソグラフィ	B-01	TU-051	ミカサ スピンコータ	ミカサ 1H-DXII	2,882	3,828	4,598	2,904	3,608	最大4インチ	レジスト等のスピンコーティング
	B-02	TU-052	アクテス スピンコータ#1	アクテス ASC-4000	3,014	4,004	4,818	3,058	3,806	最大6インチ	レジスト等のスピンコーティング
	B-03	TU-053	アクテス スピンコータ#2	アクテス ASC-4000W	3,058	4,070	4,884	3,080	3,850	最大8インチ	レジスト等のスピンコーティング
	B-04	TU-054	ホットプレート	Shamal HHP-230SQ	1,716	2,288	2,750	1,760	2,178	最大8インチ	設定温度：40～400℃、温度分布精度：±1℃
	B-05	TU-055	クリーンオープン	ヤマト科学 DE62	4,026	5,346	6,424	3,850	4,796	最大8インチ	ウェハのバーク
	B-06	TU-056	両面アライナ #1	SUSS MA6/BA6	4,158	5,544	6,666	4,136	5,148	最大6インチ	コンタクト露光、片面・両面アライメント、接合時のアライメント
	B-07	TU-056	両面アライナ #2	SUSS MA6/BA6	4,158	5,544	6,666	4,136	5,148	最大6インチ	コンタクト露光、片面・両面アライメント、接合時のアライメント
	B-08	TU-057	レーザ描画装置	Heidelberg Instruments DWL2000CE	9,240	12,320	14,784	9,526	11,902	最大9インチ角	波長：405nm、最小描画線幅：0.7μm、マスク作製（Cr、エマルジョン）、直接描画、グレイスケール露光
	B-09	TU-058	マスクレスアライナ	Heidelberg Instruments MLA150	6,314	8,404	10,098	6,534	8,162	最大8インチ角	波長：405nm 375nm、最小描画線幅：1μm、マスク作製（Cr、エマルジョン）、超高速直接描画、裏面アライメント
	B-10	TU-059	スプレー現像装置	アクテス ADE-3000S	2,860	3,806	4,576	2,838	3,542	最大6インチ	現像液とリンス（水）をノズルから噴霧
	B-11	TU-060	現像ドラフト	- -	2,112	2,816	3,388	2,112	2,618	最大6インチ	レジスト現像用のドラフトチャンバー
	B-12	TU-061	スピンド乾燥機	東邦化成 ZAA-4	2,904	3,850	4,620	2,904	3,630	最大6インチ	平置き式でウェハやフォトマスクの乾燥
	B-13	TU-062	コータデベロッパ	Suss ACS200Gen3	12,364	16,478	19,778	12,826	16,016	最大8インチ	2～8インチ、HMDS処理、コート 3ライン、現像 2ライン、エッジリンス、バックリンス、ホットプレート 4セット、クルールプレート 1セット
	B-14	TU-063	i線ステッパ	キャノン FPA-3030i5+	21,252	28,314	47,960	22,000	27,500	最大8インチ	小片～8インチ、最小線幅 0.35μm以下、重ね合せ精度 40nm、両面アライメント対応、透明基板対応、反り基板対応、Nikonレチクル対応
	B-15	TU-064	エリオニクス 130kV EB描画装置	エリオニクス ELS-G125S	10,164	13,530	16,236	10,560	13,178	最大6インチ	最大加速電圧：130keV、最小描画パターン：10nm以下
	B-16	TU-065	エリオニクス50kV EB描画装置	エリオニクス ELS-7500X	4,378	5,830	6,996	4,554	5,676	最大4インチ	最大加速電圧：50keV
	B-17	TU-066	ポリイミドキュア炉	ヤマト科学 DN43H	2,574	3,432	4,136	2,486	3,102	最大8インチ	N2雰囲気中でのポリイミドのキュア
	B-18	TU-067	UV キュア装置	ウシオ電機 UMA-802	4,774	6,358	7,634	4,774	5,962	4インチ	レジストのキュア、カセットtoカセット
	B-19	TU-068	球面露光装置	東栄科学産業 -	4,532	6,028	7,238	4,686	5,852	球面体	球面体（直径1.0、3.3mm）へのマスクレス露光、最小パターン：1.5μmハーフピッチ、アライメント精度：±5μm
	B-20	TU-069	両面アライナ #3	SUSS MA8/BA8 Gen3	5,368	7,150	8,580	5,368	6,688	最大6インチ	コンタクト露光、片面・両面アライメント
	B-21	TU-070	BEAMER PC		1,826	2,420	2,904	1,936	2,420		近接補正用ソフト(BEAMER)
酸化拡散・イオン注入・熱処理	C-01	TU-101	酸化炉 （半導体）	東京エレクトロン XL-7	13,530	18,040	21,648	13,464	16,808	最大6インチ	酸化膜形成、半導体ウェハ用
	C-02	TU-101	酸化炉 （MEMS）	東京エレクトロン XL-7	10,802	14,388	17,270	10,736	13,398	最大6インチ	酸化膜形成、MEMSウェハ用
	C-03	TU-102	酸化炉(8")	光洋サーモシステム MT-10×8-A	9,878	13,156	15,796	9,768	12,188	最大8インチ	酸化膜形成、8インチ用
	C-04	TU-103	拡散炉 （P拡散炉）	東京エレクトロン XL-7	14,388	19,184	23,034	14,080	17,600	最大6インチ	P拡散（プリデポ用）
	C-05	TU-103	拡散炉 （P押し込み炉）	東京エレクトロン XL-7	13,662	18,194	21,846	13,288	16,610	最大6インチ	P拡散（ドライブイン用）
	C-06	TU-103	拡散炉 （B拡散炉）	東京エレクトロン XL-7	13,816	18,414	22,110	13,376	16,720	最大6インチ	B拡散（プリデポ用）
	C-07	TU-103	拡散炉 （B押し込み炉）	東京エレクトロン XL-7	12,320	16,412	19,712	11,880	14,828	最大6インチ	B拡散（ドライブイン用）
	C-08	TU-104	メタル拡散炉	光洋リンドバーク Model270	9,702	12,914	15,510	9,284	11,594	最大4インチ	最高温度：1000℃、メタルや圧電基板等の多用途拡散
	C-09	TU-105	中電流イオン注入装置	日新イオン機器 NH-20SR	22,506	30,008	36,014	22,440	28,050	最大4インチ	最大加速電圧：180keV、最大電流：0.6mA、注入可能元素：P、B、カセットtoカセット
	C-10	TU-106	アニール炉	東京エレクトロン XL-7	12,100	16,126	19,360	11,726	14,652	最大6インチ	イオン注入後のアニール
	C-11	TU-107	ランプアニール装置	AG Associates AG4100	9,460	12,606	15,136	9,768	12,188	最大6インチ	最高温度：1100℃、昇温速度：100℃／sec、カセットtoカセット
	C-12	TU-108	水素アニール炉	オリジナル -	20,856	27,786	33,352	19,492	24,354	最大6インチ	最高温度：1100℃、クリーンな環境下での赤外線ランプ加熱、Si専用
	C-13	TU-109	真空アニール炉	真空理工 RHL-Pss98/98#	6,974	9,284	11,154	6,952	8,668	最大4インチ	真空中での熱処理（酸素、窒素雰囲気中の処理対応未確認）
成膜	D-01	TU-151	LPCVD （SiN）	システムサービス -	13,046	17,380	20,856	12,606	15,752	最大6インチ	SiN
	D-02	TU-151	LPCVD （Poly-Si）	システムサービス -	17,578	23,430	28,116	16,984	21,208	最大6インチ	Poly-Si
	D-03	TU-151	LPCVD （SiO2、SiON）	システムサービス -	14,872	19,822	23,804	14,784	18,458	最大6インチ	SiO2（NSG）、SiON
	D-04	TU-152	熱CVD	国際電気 -	29,370	39,160	46,992	28,138	35,156	最大6インチ	Epipoly-Si(non-doped, doped)、Poly-Si(non-doped, doped)、最高温度：1100℃
	D-05	TU-153	住友精密PECVD	住友精密工業 MPX-CVD	20,394	27,170	32,604	19,822	24,772	最大8インチ	SiN、SiO2、最高温度：350℃、低応力SiN成膜
	D-06	TU-154	住友精密TEOS PECVD	住友精密工業 MPX-CVD	21,780	29,040	37,400	21,208	26,488	最大8インチ	TEOS SiO2、SiN、最高温度：350℃、低応力成膜
	D-07	TU-155	SPPテクノロジーズ TEOS PECVD	SPPテクノロジーズ APX-Cetus	21,956	29,260	38,500	21,296	26,620	最大8インチ	TEOS SiO2、SiN、基板サイズ 小片～8インチ、最高温度 350℃、低応力SiN成膜
	D-08	TU-156	JPEL PECVD	日本生産技術研究所 VDS-5600	14,058	18,722	22,484	13,992	17,468	最大6インチ	SiN、SiO2、バッチ式：4インチ×13枚、6インチ×8枚
	D-09	TU-157	W-CVD	Applied Materials P-5000	11,770	15,686	18,832	11,792	14,740	4インチ	タングステン成膜
	D-10	TU-158	芝浦スパッタ装置（加熱型）	芝浦メカトロニクス CFS-4ESIⅡ	4,818	6,424	7,722	4,884	6,094	最大8インチ	基板ステージφ200mm、3インチターゲット×3、基板加熱形（最高300℃）
	D-11	TU-159	芝浦スパッタ装置（冷却型）	芝浦メカトロニクス CFS-4ESIⅡ	4,862	6,468	7,766	4,906	6,116	最大8インチ	基板ステージφ200mm、3インチターゲット×3、基板水冷形、リフトオフプロセス可
	D-12	TU-160	自動搬送 芝浦スパッタ装置	芝浦メカトロニクス I-Miller CFS-4EP-LL	6,996	9,328	11,198	7,238	9,042	最大8インチ	基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板加熱形（最高300℃）、ロードロック付、自動搬送付
	D-13	TU-161	自動搬送 芝浦スパッタ装置(冷却型)	芝浦メカトロニクス I-Miller CFS-4EP-LL	8,646	11,528	13,838	8,998	11,242	最大8インチ	基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板冷却型、リフトオフプロセス可、ロードロック付、自動搬送付
	D-14	TU-162	ECRロングスロースパッタ	エリオニクス EIS-200ERP-NPD-TK	6,424	8,558	10,274	6,402	7,986	最大6インチ	小片～6インチ、ターゲット数 2、ターゲット-ステージ間距離 150mm、コリメータ付、エッチング可
	D-15	TU-163	アネルバマルチスパッタ	アネルバ SPC-350	5,984	7,964	9,570	6,336	7,898	4インチ	1バッチ最大6枚搭載可能（回転機構付）、6インチターゲット×3（DC×2、RF×1：同時放電可能）、基板加熱形（最高650℃）、強磁性体対応、ロードロック付、クライオポンプ
	D-16	TU-164	酸素加圧RTA付高温スパッタ装置	ユーテック 21-0604	13,508	17,996	21,604	12,672	15,818	最大8インチ	金属用(DC)スパッタチャンバ、酸化物用(RF)スパッタチャンバ、酸素加圧アニールチャンバの3つのチャンバで構成。最高基板温度は700℃。主にPZT下地成膜、PZT成膜用。
	D-17	TU-165	アネルバスパッタ装置	アネルバ SPF-730	8,778	11,682	14,036	8,888	11,088	最大6インチ	1バッチ9枚（4インチ）、8インチターゲット×3
	D-18	TU-166	球面成膜用スパッタ装置	和泉テック -	5,214	6,930	8,316	5,522	6,886	球面体	球面体（直径1.0、3.3mm）へのスパッタリング、膜種：Au、Cr、Al、Pd、SiO2他、O2プラズマクリーニング可
	D-19	TU-167	電子ビーム蒸着装置	アネルバ EVC-1501	7,722	10,274	12,342	7,744	9,658	最大6インチ	主に金属薄膜の蒸着
	D-20	TU-168	めっき装置	山本鍍金試験器 特注	2,816	3,740	4,488	2,794	3,476	最大6インチ	Cu、Ni、Sn、Au
	D-21	TU-169	多元材料原子層堆積(ALD)装置	テクノファイン ALK-600	10,340	13,772	16,544	10,912	13,640	最大6インチ	アルミナ等のALDが可能。6インチウェハまでの導入が可能。アルミナ以外は、要原料。
	D-22	TU-170	ゾルゲル自動成膜装置	テクノファイン PZ-604	8,778	11,704	14,058	9,020	11,264	最大4インチ	PZT成膜
	D-23	TU-171	MOCVD	ワコム研究所 Doctor-T'	17,798	23,716	28,468	18,018	22,506	最大8インチ	PZT成膜等
	D-24	TU-172	シンクロン スパッタ装置	シンクロン RAS-1100B Ⅱ	59,334	79,112	99,000	61,996	77,484	4インチ	36枚同時成膜が可能。Si、Ta、Al、W、SiO2、Ta2O5成膜可能。

エ ッ チ ン グ	E-01	TU-201	DeepRIE装置#1	住友精密工業 MUC-Z1 ASE-SRF	9,372	12,474	14,982	9,592	11,808	最大6インチ	Siの深堀エッチング、メカニカルチャック
	E-02	TU-202	DeepRIE装置#2	住友精密工業 MUC-Z1 ASE-SRF	9,372	12,474	14,982	9,592	11,808	最大6インチ	Siの深堀エッチング、メカニカルチャック
	E-03	TU-203	DeepRIE装置#3	STS Multiplex-ICP SR	9,988	13,310	15,972	10,208	11,974	最大6インチ	Siの深堀エッチング、メカニカルチャック
	E-04	TU-204	DeepRIE装置#4	住友精密工業 MUC-Z1 ASE-HR	16,368	21,824	26,202	16,786	20,080	最大8インチ	Siの深堀エッチング、静電チャック
	E-05	TU-205	アルバックICP-RIE#1	アルバック NE-550	19,206	25,586	30,712	18,304	21,998	最大6インチ	SiO2、メタルなどの多目的ドライエッチング、静電チャック、ガス：CF4、CHF3、SF6、Ar、O2、N2、Cl2、BCl3
	E-06	TU-206	アルバックICP-RIE#2	アルバック CE-300I	18,150	24,200	29,040	17,512	21,138	最大6インチ	SiO2、メタルなどの多目的ドライエッチング、静電チャック、ガス：CF4、CHF3、SF6、Ar、O2、N2、Cl2、BCl3
	E-07	TU-207	アルバック多用途RIE装置	アルバック RIH-1515Z	11,748	15,664	18,810	11,440	14,028	最大6インチ	金属膜や圧電膜も対象とした多目的のドライエッチング、ガス：Cl2、BCl3、SF6、CF4、CHF3、Ar、N2、O2
	E-08	TU-208	アネルバRIE装置	アネルバ DEA-506	9,086	12,100	14,520	8,844	10,906	最大8インチ	SiN、SiO2のドライエッチング、ガス：CF4、CHF3
	E-09	TU-209	アネルバSi RIE装置	アネルバ L-507DL	7,172	9,548	11,462	7,304	9,186	最大6インチ	Siのドライエッチング、ガス：SF6
	E-10	TU-210	AI-RIE装置	芝浦メカトロニクス HIRRIE-100	12,672	16,874	20,262	12,870	16,100	最大6インチ	AlやSiのドライエッチング、カセットtoカセット、ガス：Cl2、BCl3
	E-11	TU-211	プラズマクリーナー	ヤマト科学 PDC210	3,828	5,104	6,138	3,982	4,860	最大6インチ	O2またはArによるウェハ表面のプラズマクリーニング、レジストアッシング
	E-12	TU-212	アルバック アッシング装置	アルバック UNA-2000	4,950	6,578	7,898	5,038	6,162	最大6インチ	2.45GH z、カセットtoカセット
	E-13	TU-213	ブランソン アッシング装置	ブランソン IPC4000	4,576	6,094	7,326	4,576	5,608	最大6インチ	13.56MH z
	E-14	TU-214	ケミカルドライエッチャー(CDE)	芝浦メカトロニクス CDE7	7,282	9,702	11,660	7,304	9,016	最大4インチ	ラジカルによる低ダメージのSi、SiN等方性ドライエッチング、DRIE後のスキラップ除去、ガス：CF4、O2、N2
	E-15	TU-215	イオンミリング装置	エヌ・エス／伯東 20IBE-C	11,022	14,674	17,622	11,484	14,160	最大6インチ	Arイオン、4インチ×6枚、6インチ×3枚
	E-16	TU-216	Vapor HFエッチング装置	住友精密工業 Primaxx uEtch	9,548	12,716	15,268	9,614	11,752	最大8インチ	気相フッ酸による主にSiO2犠牲層エッチング
	E-17	TU-217	KOHエッチング槽	-	3,300	4,378	5,258	3,322	4,140	最大6インチ	Si結晶異方性エッチング
	E-18	TU-218	TMAHエッチング槽	-	4,026	5,368	6,446	3,938	4,804	最大6インチ	Si結晶異方性エッチング
接 合 ・ 研 磨 ・ パ ッ ケ ー ジ ン グ	F-01	TU-251	SUSS ウェハ接合装置	SUSS SB6e	7,502	9,988	11,990	7,546	8,074	最大6インチ	陽極接合、金属接合、ポリマー接合
	F-02	TU-252	EVG ウェハ接合用アライナ	EVG Smart View Aligner	5,918	7,876	9,460	5,852	7,244	最大8インチ	IR透過アライメント可能
	F-03	TU-253	EVG ウェハ接合装置	EVG 520	6,358	8,470	10,164	6,402	7,848	最大8インチ	熱圧着接合用
	F-04	TU-254	EVG プラズマ活性化化装置	EVG 810	8,382	11,176	13,420	8,602	10,454	最大6インチ	直接接合前のプラズマ活性化処理 標準ガス：N2
	F-05	TU-255	ディスコ ダイサ	ディスコ DAD-522	3,432	4,576	5,500	3,586	4,136	最大6インチ	切削水：水道水
	F-06	TU-256	東京精密 ダイサ	東京精密 0	10,164	13,530	16,236	10,516	12,958	最大6インチ	切削水：純水
	F-07	TU-257	ワイヤボンダ	Westbond -	1,870	2,486	2,992	1,892	2,304	チップ	Al、Au
	F-08	TU-258	レーザマーカ	GSIルモニクス WM-II	3,300	4,400	5,280	3,344	4,106	4インチ	ウェハのマーキング
	F-09	TU-259	サンドブラスト	新東 -	5,060	6,732	8,096	4,994	4,790	最大6インチ	ガラスの穴あけ加工
	F-10	TU-260	4インチウェハ研磨装置	BNテクノロジー Bni52	2,046	2,706	3,256	1,980	2,658	最大4インチ	Si、SiO2、金属などの研磨、CMP
	F-11	TU-261	6インチウェハ研磨装置	BNテクノロジー Bni62	2,310	3,058	3,674	2,266	3,040	最大6インチ	Si、SiO2、金属などの研磨、CMP
	F-12	TU-262	サーフェイスプレーナー	ディスコ DAS8920	18,810	25,080	30,096	18,832	19,850	4、8インチ	Au、Cuバンプの平坦化
	F-13	TU-263	UVインプリント装置	東芝機械 ST-50	6,622	8,822	10,604	6,974	8,122	最大4インチ角	UV光を用いたインプリント装置、ステップ&リピート可能
	F-14	TU-264	熱インプリント装置	オリジン電気 Reprina-T50A	6,204	8,272	9,944	6,556	8,138	最大2インチ角	最大650℃、最大30kN
	F-15	TU-265	エキシマ洗浄装置	デアネヒステ EXC-1201-DN	3,498	4,664	5,610	3,388	4,136	最大4インチ	ウェハや石英モールド上の有機物の除去
	F-16	TU-266	セミオートワイヤボンダ	TPT HB16 セミオート	1,804	2,398	2,882	1,826	2,214		ボールボンド、ウェッジボンドの両方が可能、セミオート対応
	F-17	TU-267	サブフェルト・インクジェット	SIJテクノロジ PR150-THU	4,422	5,874	7,062	4,576	5,596		最小線幅：約5um
	F-18	TU-268	光造形3Dプリンター	シーフース 0283 plus Build size: 90x90x90mm Layer thickness (min): 0.01mm XY accuracy: 0.02mm	2,948	3,916	4,708	2,926	3,476		最小積層ピッチ：0.01mm、最大造形サイズ：90mm x 90mm x 90mm
	F-19	TU-269	マイクロマニピュレータ	マイクロサポート	1,936	2,574	3,102	1,870	2,264		マイクロスコープ体型マイクロマニピュレーターシステム
	F-20	TU-270	ウォーターレーザ	澁谷工業 LAMICS AQL-1900	6,732	8,954	10,758	6,908	7,860	最大12インチ	シリコンウェハや金属薄板の加工（ガラスなどの透明材料はNG）、最小加工線幅：約70μm
測 定	G-01	TU-301	ウェハゴミ検査装置	トプコン WM-3	2,728	3,630	4,356	2,816	3,366	最大6インチ	ウェハ上のパーティクル測定（数、大きさ）
	G-02	TU-302	膜厚計	ナノメトリクス NanoSpec3000	2,112	2,794	3,366	2,156	2,600	最大6インチ	光学式の膜厚測定
	G-03	TU-303	卓上型エリブソ	フォトニクラティス SE-101	1,320	1,760	2,112	1,408	1,820	最大6インチ	高速サンプリング可能なエリブソ
	G-04	TU-304	エリブソ	アルバック -	1,606	2,134	2,574	1,672	2,074	最大6インチ	薄膜の厚さ、屈折率測定
	G-05	TU-305	Dektak 段差計	Dektak 8	2,376	3,146	3,784	2,420	2,912	最大6インチ	触針式の表面形状測定
	G-06	TU-306	Tencor 段差計	Tencor AlphaStep	2,332	3,102	3,740	2,420	2,912	最大6インチ	触針式の表面形状測定
	G-07	TU-307	金属顕微鏡	ニコン L150、L200	2,002	2,662	3,212	2,046	2,296	最大6インチ	パターン観察
	G-08	TU-308	デジタル顕微鏡	キーエンス／クノータクノクラフト -	2,288	3,036	3,652	2,288	2,802	最大8インチ	パターン観察、デジタル画像保存、電動ステージ（PC制御可）、20～200倍、500～5000倍
	G-09	TU-309	赤外線顕微鏡	オリンパス/浜松ホトニクス -	1,914	2,552	3,080	1,936	2,390	最大6インチ	両面アライメントの確認、ウェハ接合面のボイド評価等
	G-10	TU-310	レーザ／白色共焦点顕微鏡	レーザーテック OPTELICS HYBRID LS-SD	5,610	7,480	8,976	5,654	6,996	最大6インチ	3次元表面形状測定、DeepRIEのエッチ深さ測定、レーザ光／白色の切替可能、共焦点／非共焦点の切替可能
	G-11	TU-311	深さ測定装置	ユニオン光学 Hisomet	1,606	2,134	2,574	1,606	2,054	最大6インチ	光学式の非接触深さ測定装置
	G-12	TU-312	超音波顕微鏡	インサイト IS-350	2,464	3,278	3,938	2,442	3,092	最大12インチ	デバイス内部の非破壊検査、ウェハ接合面の欠陥、ボイド評価等
	G-13	TU-313	マイクロX線CT	コムスキャンテクノ ScanXmate D160TS110	4,004	5,324	6,402	4,136	5,130	最大6インチ	X線を用いた非破壊内部観察
	G-14	TU-314	熱電子SEM	日立ハイテック S3700N	4,290	5,698	6,842	4,224	5,188	最大12インチ	EDX付、低真空モード付、光学画像ナビゲーション付
	G-15	TU-315	断面SEM	日立ハイテック S5000	5,962	7,942	9,548	6,006	6,804	小片	小片専用、インレンス式の高分解能FESEM
	G-16	TU-316	JEOL FE-SEM	日本電子 JSM-6335F	6,072	8,096	9,724	6,160	7,554	最大4インチ	電界放出型SEM、EDX付
	G-17	TU-317	測長SEM	日立ハイテック CS4800	18,062	24,068	28,886	18,810	21,088	最大8インチ	微細構造の高精度自動測長 6、8インチは自動搬送、4インチ以下は手動搬送 計測再現性：1nm(3σ)
	G-18	TU-318	クイックコータ	サンヨー電子 SC-701MkII	1,848	2,442	2,948	1,870	2,644	最大2インチ	SEM観察試料のPtコーティング
	G-19	TU-319	パーク・システムズAFM	パーク・システムズ NX20	3,674	4,884	5,874	3,630	4,112	最大8インチ	小片から8インチまで対応する原子間力顕微鏡
	G-20	TU-320	4探針測定装置	-	1,518	2,002	2,420	1,606	2,180	最大6インチ	ウェハ抵抗率などの測定
	G-21	TU-321	拡がり抵抗測定装置	Solid State Measurement SSM150	2,882	3,828	4,598	2,970	4,118	小片	不純物濃度プロファイルの測定、ウェハを小片にして端面を斜め研磨した後に測定
	G-22	TU-322	FIB	SII SMI9200	10,010	13,332	16,016	10,670	12,314	小片	集束イオンビームによる微小部分のエッチング、SEM観察用断面作製
	G-23	TU-323	XRD	ブルカー・エイテックスエス D8 DISCOVER	10,648	14,190	17,028	10,736	12,910	最大6インチ	X線回折測定、1000℃までの高温環境での測定可能
	G-24	TU-324	直線集束ビーム超音波材料解析システム#1	オリジナル -	3,696	4,928	5,918	3,696	5,636	最大6インチ	固体試料の漏洩弾性表面波(LSAW)速度測定
	G-25	TU-325	直線集束ビーム超音波材料解析システム#2	オリジナル -	4,224	5,610	6,732	4,246	5,636	最大8インチ	固体試料のバルク波（縦波、横波）音速測定
	G-26	TU-326	Zygo Nexview	Zygo	2,970	3,938	4,730	2,772	4,864	最大6インチ	表面形状の精密測定
	G-27	TU-327	半導体パラメータアナライザ	Key Sight B1500A SMU B1511B x4 GNDU B1500-66605	1,672	2,222	2,684	1,584	2,170		半導体デバイスの特性評価
	G-28	TU-328	2光子励起顕微鏡	ライカ	3,630	4,840	5,808	3,696	4,196		マルチフォトンレーザ顕微鏡システム、超解像オプション付、細胞の高精細蛍光イメージング
	G-29	TU-329	分光エリブソ	ジェー・イー・ウーラム・ジャパン株式会社 RC2-UI-TTK	6,358	8,470	10,164		新規	最大8インチ	測定波長域：210～1690 nm、入射角可変範囲：45～90度、ビーム径：通常3 mm サンプルステージ：φ200 mm（自動マッピング、自動アライメント機構付） 測定データ：分光エリブソメトリデータ（ψ Δ）、ミューラー行列16成分、透過率、反射率、偏光解消度 解析ソフトウェア：CompleteEASE